



推奨基板取付け寸法  
PC 基板厚: 1.6 ± 0.1  
(非累積公差)  
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1  
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
  - FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
  - FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
  - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
  - めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.38 μm MIN 金めっき
  - めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.76 μm MIN 金めっき
  - めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
  - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の土に半田めっき
  - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の土にスズめっき

OBSOLETE		Y	△6 △4	2-316132-5
			△6 △3	2-316132-3
			△6 △2	2-316132-2
		X	△6 △4	1-316132-5
			△6 △3	1-316132-3
			△6 △2	1-316132-2
	キーイング位置 KEYING LOCATION	キーイング KEYING	FINISH	製品番号 PART NO.

Copyright © 1995 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				DYNAMIC D-3200S 5.08 PITCH (V) 5 極 ヘッダーアセンブリー			
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME			
mm (AWG)		mm		ダイナミック D-3200S 5.08 ピッチ (V) 5 極 ヘッダーアセンブリー			
MATERIAL		FINISH		DYNAMIC D-3200S 5.08 PITCH (V) 5 POS. HDR. CONN. ASS'Y			
SEE NOTES		SEE NOTES		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
注記参照		注記参照		SIZE LOC NUMBER			
DR. 26/JUL/95		DE. 26/JUL/95		A3 J C=316132			
K.IKEDA		K.IKEDA		SCALE REV. SHEET			
CHK. 2/AUG/95		APP. 2/AUG/95		2-1 C 1 OF 1			
Y.ISHIKAWA		S.MANABE					
LTR REVISION RECORD		DR CHK DATE					

NUMBER 316132  
 3rd ANGLE PROJECTION  
 METRIC  
 DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT  
 PRINT DIST  
 AMP-J REV.10/83